

半導體資安課程規劃與活動規格說明

需求背景:半導體資安課程可協助台灣半導體產業鏈增加資訊安全的實力與國際標準的最新訊息.本案預計針對台灣半導體共應鏈資安需求設計半導體系列課程與活動 2 場:

半導體資安課程以依下列資訊規劃:

1. 所涵蓋規範與標準:(1) NIST 2.0 標準;(2) ISO 27001;(3) 上市上櫃公司資通安全管控指引;(4) SEMI E187 ;(5) SEMI E188;(6) 國際大廠合約內容資安規範
2. 國際大廠合約內容資安規範,以各大廠網路公開可查閱內容為主, 包含:TSMC、DELL, HP, INTEL, ...
3. 半導體產業之垂直與水平連結之產業:IC 設計、矽智財、材料(商)、生產設備(商)、光罩製作、晶圓製造/代工、封裝、測試、Fab、倉儲物流以及各產業內 IT

驗收 KPI

1. 半導體資安課程規劃內容一式(至少 3 模組)
2. 舉辦半導體資安課程活動 2 場(議題規劃/講師邀約/場地/講師費/租借/餐飲/活動文宣:如 EDM 設計等)